東海大學研發成果專利申請表

（專利申請表1）

申請日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 專利申請名稱
 | 中文 |  |
| 英文 |  |
| 1. 發明人代表
 | 姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 單位/職稱 |  | E-mail |  |
| 1. 聯絡人
 | 姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 單位/職稱 |  | E-mail |  |
| 1. 智慧財產權歸屬
 | □本校□共有（請填寫下列共有單位名稱及成果歸屬比例）本校【 %】、共有單位 【 %】註：請檢附共有合約書□其他（請說明）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_註：請勿以個人名義持有專利，若因特殊狀況(如因應專利申請國之要求)，以個人名義申請專利者請說明，並由研發成果管理委員會審議之，後續應填具「東海大學專利權讓與申請表」主動讓與本校。 |
| 1. 本研發成果來源

（計畫主持人須為發明人代表） | □國科會　□農業部　□經濟部　□其他補助機關： □一般產學合作計畫　□本校教師職務成果（勾選本項者，免填下列欄位） |
| 計畫編號： 校內計畫序號：計畫名稱： |
| 1. 申請國家及類型
 | □中華民國　□美國　□日本□其他國家： 　理由： 　　　　  |
| □發明專利　 □新型專利 □設計專利 |
| 1. 公開揭露紀錄
 | 是否已公開？□是　　　　　　　　□否，但未來會公開□否，未來亦無公開之計畫（勾選本項者，下列公開資料免填） |
| 已（或預計）公開之方式及日期：□學位論文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_（口試日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；繳交日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日）□國內外期刊：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投稿日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；(預計)出版日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日）□技術公開演說：發表日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（活動型式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，例如：新聞、海報、口頭、書面等）□計畫結案報告日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_註：揭露本項資訊者，請檢附已發表之期刊、論文……等（如為外文，須附中譯本）。 |
| 1. 檢附資料
 | □專利申請表（表1）□專利申請費用分攤暨權益收入分配協議書（表2）□專利申請說明書（表3）□計畫經費核定清單或計畫合約書影本。□本申請案之電子檔請E-mail至產學與育成中心[iic@thu.edu.tw](file:///D%3A%5C1.%E2%98%85%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%AC%8A%5C1.%E2%98%85%E5%B0%88%E5%88%A9%5C1.%E2%98%85%E6%9C%AC%E6%A0%A1%E8%B3%87%E6%96%99%28%E5%90%AB%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E3%80%81%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E3%80%81%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%A1%88%E4%BB%B6%E8%B3%87%E6%96%99%29%5C1.%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%8F%8A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%A1%A8%E6%A0%BC%5C2.%E5%B0%88%E5%88%A9%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A1%A8%E5%96%AE%5C1.%E7%94%B3%E8%AB%8B%5Ciic%40thu.edu.tw)。□其他（如已發表論文等）： 。 |
| 申請單位 | 研發處 |
| 發明人代表簽章 | 單位主管 | 一級主管 | 一級主管 |

＊東海大學（以下簡稱本校）為雙方業務合作聯繫之目的，須蒐集辦理專利申請事宜所需之姓名、職稱、住址、行動電話、電子郵遞地址、金融機構帳戶之號碼與姓名、身分證統一編號、年齡、性別、出生年月日等個人資料(辨識類：C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者；特徵類：C011個人描述)，以在雙方合作關係存續期間及地區內進行必要之聯繫。

＊本校於蒐集您的個人資料時，如有欄位未確實填寫，則可能對雙方之合作聯繫有所影響。如欲更改個人資料或行使其他個人資料保護法第3條的當事人權利，請洽本校產學與育成中心。

東海大學研發成果
專利申請費用分攤暨貢獻比率及權益收入分配協議書

（專利申請表2）

（適用權利為【本校】）

一、專利名稱： 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　。

二、申請國別： 　　　　　　　　　　 。

三、發明人專利費用分攤及權益收入分配，將依本校「研究發展成果管理辦法」及本協議書辦理。

（一）**專利費用分攤比率**及**收益分配比率**說明：

扣除資助機關補助金額後，專利申請費用（如專利申請之申請費、證書費、第一期專利年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之專利規費等）之負擔比率得由本校人員之發明人依下列方案自行選擇其中之一，並經研發成果管理委員會決議之。
此五種方案之選擇將影響研發成果收益之分配比率。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 專利費用分攤方案 | 專利申請費用分攤（%） | 收益分配比率（%） |
| 本校 | 發明人 | 本校 | 發明人 |
| **一** | 100 | **0** | 75 | **25** |
| **二** | 85 | **15** | 55 | **45** |
| **三** | 70 | **30** | 40 | **60** |
| **四** | 55 | **45** | 25 | **75** |
| **五** | 0 | **100** | 15 | **85** |

（二）本案經所有發明人一致同意選擇第 方案為與學校之專利費用分攤比例。

**註：如有非屬本校人員，請加填「非本校所屬發明人專利聲明書」。**

四、若發明人為二人(含)以上，請自行協調並於下表填寫發明人部分之費用拆分方式、貢獻比例與權益收入分配比例。日後有關發明人權益收入分配，將依此原則辦理之。

（一）本專利之專利申請費用發明人部分**拆分**方式（即不含學校分攤部分）：

□統一由發明人代表統籌處理。（若勾選本項，下方欄位免填）

□由產學與育成中心協助以下列繳款比例拆分專利費用，惟請發明人代表協助聯繫：

| 序號 | 發明人姓名 | 費用拆分比例 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （發明人代表） | % |  |
| 2 |  | % |  |
| 3 |  | % |  |
| 合 計 | 100% |  |

（二）本專利之**貢獻比例**與**權益收入分配**比例：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 發明人姓名 | 貢獻比例 | 權益收入分配比例 | 備註 |
| 1 |  （發明人代表） | % | % |  |
| 2 |  | % | % |  |
| 3 |  | % | % |  |
| 合 計 | 100% | 100% | **如有非屬本校人員，請加填「非本校所屬發明人專利聲明書」** |

**註：權益收入分配比例於全體發明人同意下，可依實際技轉情形重新調整。**

五、所有發明人一致同意上表發明人協議之與學校之專利費用分攤比例、貢獻比例、費用分攤方式及權益收入分配比例等內容：

1. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
2. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
3. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日

東海大學研發成果專利申請說明書

（專利申請表3）

一、發明人資料**（必填）**

|  |
| --- |
| 本案發明人共 位 |
| 1 | 姓名 |  | 英文姓名 |   |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  |
| 戶籍地址 |  |
| 2 | 姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  |
| 戶籍地址 |  |
| 3 | 姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  |
| 戶籍地址 |  |

註1：發明人如超過3人，不敷使用時請自行增加欄位。

註2：發明人若非中華民國國籍，身分證字號請填「居留證號碼」。

二、專利資料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）有關此發明最早的紀錄 | 日期 |  |
| 公開資訊 |  |
| （二）相關先前技術調查情形 | 1. 已檢索之專利資料庫（Database）
2. 已檢索之關鍵字（Keyword）

中文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_英文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. 相類似技術或已經發表之文獻
 |
| （三）研發領域（請先選大類，再選細項，**可複選**）**（必填）** | □資通電控 | □資訊工程　□電信工程　□電腦通訊　□微電子工程　　□網路科技　□光電工程　□電力工程　□自動化控制□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □工程科技 | □機械工程　□土木工程　□水利工程　□材料工程□環境工程　□醫學工程　□奈米科技　□微流體晶片□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □生物科技 | □基因工程　□生醫檢測　□生物藥學　□生物晶片□微生物　　□動物疫苗　□資電晶片　□蛋白質工程□保健食品　□農業技術　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □材料化工 | □藥物化學　□材料化學　□光電材料　□化妝品化學　□分析化學　□生醫材料　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □管理 | □資訊系統管理　□工業管理　□電信管理□企業管理模式　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □其他 | □生活應用　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| （四）本技術創作目的**（必填）** |  |
| （五）技術摘要**（必填）**　（簡述本技術的特徵，並說明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途，以200字左右為宜） |  |
| （六）本發明之特色**（必填）**（以至少一個最佳實施例說明本發明之技術與特徵） | * 1. 既有技術之比較
	2. 本發明之特點
 |
| （七）發明或創作說明**（必填）**（應載明有關之先前技術，發明或創作之目的、技術內容、特點、功效及圖示說明，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施） |  |
| （八）申請專利範圍**（必填）**（即claims，應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵；亦即應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。） |  |
| （九）圖示**（必填）** |  |

三、技術推廣

|  |  |
| --- | --- |
| （一）技術成熟度 | □量產階段　　　□試量產階段　　□雛型階段□實驗室階段　　□概念階段　　　□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| （二）產業應用性**（必填）**（請詳細列舉此技術可能應用的產業、可運用本技術之產品、方式等） | 1. 產業利用性說明
2. 是否正在（或將要）進行相關產學合作或技術授權
 |
| （三）適用產業類別**（必填）** | □積體電路產業　□電腦及週邊產業 □通訊產業　　 □光電產業□精密機械產業　□運輸工具產業　 □機械設備製造 □製藥工業□化學製品製造業□化學材料製造業　□石油及煤製品製造業□橡膠製品製造業□農藥工業　　　□生物技術產業　□食品製造業　 □電子產業 　□金屬製品製造業□非金屬製品製造業　□紡織業　　 □印刷電路板　　□出版業　　　　□營建業　　　　 □環境檢測　 □諮詢顧問業　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿ |
| （四）技術承接單位應具備條件之建議 | 1. 潛在廠商：

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. 廠商應具備之專門技術：
2. 廠商應有設備：
 |